20260901 旺矽(6223 TT) 法說會 Memo by Sinopac

1. 營運近況
   A. 2Q26 產品比重：探針卡 74.7%、設備 23.3%（Thermal / AST）、其他 3.0%。
   B. 2Q26 營收 52.33 億元（+33.1% QoQ、+58.9% YoY），毛利率 58.4%，季減約 1ppt，主因產品組合轉差；業外匯兌利益 0.6 億元，稅後淨利 15.24 億元（+24.1% QoQ、+142.5% YoY），稅後 EPS 15.55 元。
   C. 2Q26 現金、A/R 明顯提升，固定資產增加 70 億元，包含擴產所需設備、土地及廠房設施。
2. 營運展望
   A. 2H26 毛利率有望逐步回升至 1Q26 水準，4Q26 有望挑戰新高。
   B. 2026 年費用率預估為 25-27%。
   C. 目前美元匯率對營運影響較大，公司產品約 70% 以美元計價，因此匯兌損益易受匯率波動影響。

QA

3. CPO 設備進度？
   A. 公司聚焦 I2、I3 設備，預期未來市場有望顯著成長，且公司與國際大廠密切合作。I2 持續認證中，預估 3Q26、4Q26 將有結果。
   B. I3 將於 4Q26 開始出貨給國際大廠，客戶包含 Foundry、OSAT、Fabless。初期出貨工程用機台，2027 年有望進入量產。
4. 公司與漢測的競爭關係？
   A. I2 產品難度很高，目前全球僅旺矽與 Ficontec 有相關產品。競業產品有一些狀況，因此客戶請漢測進行調整。我們認為公司與漢測不算競爭關係，與 Ficontec 則偏向競爭關係。
5. CPO 量產時間？
   A. 2026 年皆為工程機台，屬於小量出貨；2027 年將有量產機會。
6. I3 是否被客戶搶單？
   A. I3 於 4Q26 就會出貨給國際大廠。目前市場仍處於初期起步階段，本來就不會只有一家供應商。旺矽客戶皆為國際大廠，與競業有所區隔。
   B. I3 內有 4-5 道測試階段，許多廠商也有出貨其他設備。旺矽主要進行 OE die 測試，偏向前段，公司也不確定競業切入哪個階段。市場規模很大，可以容納多家廠商。
   C. I3 Ficontec 與公司是否重疊，目前很難判斷。
7. 公司 2Q26 毛利率低於預期，是否因客戶砍價？
   A. 2Q26 毛利率下滑係因產品組合影響，並非殺價競爭。
   B. 2Q26 公司 CPC 漲價 20%，也取消 VPC / MEMS 探針卡約 10% 的優惠。
   C. 目前國際競業與旺矽都在積極擴產，市場需求遠高於產能供給。全球前三大探針卡廠商也持續擴產，公司的 BB ratio 自 4Q25 起持續維持高檔水準，因此公司沒有動機向客戶降價。

8. 旺矽與義大利廠商 Technoprobe 的侵權議題？
   A. 過去十年 TPI、FFI 兩家公司時常互相提告，法律訴訟偏向商業手段。旺矽十分重視專利，公司過去持續專注於技術研究，探針、載板自製是少數廠商能達到的能力。若非專注研發，公司不會有目前的成長成果。公司 RD 同仁開發新產品時會研讀相關專利，並與專利公司合作，盡量避免侵權；公司在研究過程中發現 TPI 有侵權行為，因此提起告訴。
   B. 國際廠商對旺矽提告，偏向希望減緩旺矽開發進程。旺矽客戶名單包含全球許多大型公司，若真有重大侵權問題，客戶不會長期與旺矽密切合作。
9. 2H26 毛利率回升原因？
   A. 2026 年毛利率回升主要與產品組合有關。2Q26 因毛利率較低產品出貨較多，2H26 出貨將有較多高毛利率產品，因此產品組合有望轉佳。
   B. 4Q26 工程機出貨營收主要於 2027 年認列，設備出貨後仍需客戶驗證，完成後才能認列後續營收。
10. 探針卡營收認列為 90 天，主要是驗證通過後才能認列？設備營收認列是否相同？
   A. 設備營收於出貨時認列 70%，客戶驗證完成後認列剩餘 30%。
11. MEMS 探針卡擴產是否有 delay？
   A. 2027 年底目標為 VPC 每月新增 50 萬針，MEMS 每月至少新增 250 萬針。
   B. 2026 年底會根據客戶需求再更新 2027 年擴廠狀況，擴產進度一定會高於目前展望。
   C. 公司通常不會在年中展望 2027 年狀況，會在蒐集完整客戶資料後於年底進行規劃。
12. 公司與競爭對手狀態？
   A. 探針卡占晶片 BOM 成本很小，客戶不會輕易更換供應商。目前公司與客戶合作的所有產品，客戶都十分滿意，因此沒有急迫更換供應商的需求。
   B. 公司對專利權非常謹慎。
13. CPC 漲價 20%，CPC 應用主要在特定領域且變化不大，目前漲價原因是否來自其他新應用？
   A. CPC 主要用於 Driver IC。消費性產品過去幾年成長相對較低，但原料持續漲價，導致公司毛利率持續被壓縮，因此需要適時反映產品價格，也可順勢篩選毛利率較低的客戶。漲價 20% 客戶相對能接受，因探針卡占 BOM cost 極小；漲價主因為原料壓力，客戶可以理解。
14. CPC 漲價是否有其他原因？VPC / MEMS 是否會漲價？
   A. CPC 產能維持每月 50 萬針，沒有其他應用或特殊原因導致漲價。
   B. VPC / MEMS 漲價方面，目前國際大廠都維持價格平穩，尚未漲價。但市場供給十分吃緊，2027 年有機會看到漲價，不過前提是各家供應商各有主要客戶。旺矽是 AI ASIC 主要供應商，漲價是否影響市占率仍需考量。
   C. 若國際大廠率先漲價，公司管理層會視情況調整；但若國際大廠維持現狀，公司也不會主動變動，因大家都不樂見探針卡漲價導致市場版圖變動。
15. 2027 年是否以合理毛利率、維持客戶長期關係，以及協助客戶順利量產作為主要考量？

A. 漲價是雙面刃，公司主要重視與客戶維持長期合作關係。目前公司毛利率已達 60%，且毛利率提升來自公司 in-house 研發成果及同仁努力，因此客戶沒有理由認為公司賺取過多不合理利潤。

B. 2023 年公司是所有探針卡廠商中營收成長的公司。當時處於半導體循環下緣，許多客戶把其他訂單收回來交給旺矽，主因是感謝公司在 2021-2022 年沒有漲價；當時旺矽並未與競業同步漲價。

16. VPC 大客戶是否規劃轉往 MEMS？目前 VPC 展望 2027 年每月擴充 50 萬針，是否太保守？

A. 可以肯定該客戶未來兩年都不會轉往 MEMS。目前所有專案都在進行中，沒有認證失敗的傳言。

B. VPC 每月擴充 50 萬針是初步想法，明年擴產計畫一定不會低於此水準，年底將詳細說明。

17. MEMS 針相關製程方式？

A. 主要為蝕刻後進行電鍍。

18. 2027 年 CAPEX？

A. 2026 年 CAPEX 為 27 億元，1H26 買了兩塊地，主要供 CPO 產線使用，其餘廠區則用於探針生產。

B. 2027 年 CAPEX 預估 12-16 億元。若需擴充土地，通常約需 10 億元；近年公司 CAPEX 維持約 10 億元水準。

C. 未來若有適合土地會購入，也會考量租賃廠房。由於擴廠至少需要三年，若使用既有廠房建物，修繕完畢後即可開始進行 CPO 擴產。